

各 位

2000年11月14日  
日本特殊陶業株式会社  
日本アイ・ビー・エム株式会社

### 日本特殊陶業とIBM、セラミック・パッケージ供給で合意

日本特殊陶業株式会社（本社：名古屋市、社長：金川重信）とIBMコーポレーション（本社：米国ニューヨーク州アーモンク、会長：ルイス・V・ガースナー）は、このたび日本特殊陶業からIBMにセラミック・パッケージを今後複数年にわたり供給することで合意しました。

先月IBMが発表した大規模な投資による生産の増強に加え、今回の合意により、2001年の中旬までにIBMのパッケージ供給量は3倍強に増える予定です。

IBMのセラミック材による先端パッケージング技術は、空前の需要を受けており、それに対応すべくIBMは既存工場の生産性の向上および生産能力の増強を行っています。今回、IBMはさらに日本特殊陶業からの支援を受けることにより、IBMのセラミック・パッケージの生産能力をより増補していきます。

セラミック・パッケージは主に多くの入出力信号端子が必要とされ、均一のチップパワー配分、高い冷却能力、そして高信頼性を必要とするネットワーク機器やウェブサーバーなどの高性能装置に使われています。今回の合意の下、日本特殊陶業はアルミナ系絶縁体と金属導体を使用して製造されるセラミック・パッケージをIBMに生産、供給していきます。

日本特殊陶業は、既存の設備を使用することで早急にIBM向けのセラミック・パッケージの生産を立ち上げています。それと平行して、2001年の第2四半期初めからの生産開始を予定して、本年8月から新工場を建設中です。日本特殊陶業は今後IBMと共に、e-ビジネス環境の発展を支援するのに必要な、高い性能を持つチップ・パッケージ・ソリューションを提供していきます。

今回のIBMと日本特殊陶業との合意は、先月IBMが発表したパッケージ製品の生産規模を増強するための大規模な投資計画を増補するものです。IBMの投資は米国ニューヨーク州イースト・フィッシュキルとエンディコット、滋賀県野洲の各施設および中国の上海に新たに3億ドルかけて設立されるオーガニック・パッケージ生産施設に対して行われています。

以上

（お問い合わせ先）

日本特殊陶業株式会社 取締役総務部長 橋本 玄次郎 Tel: 052-872-5915  
日本アイ・ビー・エム株式会社 広報 須山 和彦 Tel: 03-5563-4300

（注記）上記文面は、11月13日の米国東部時間早朝に発表されたリリースの翻訳です。